

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年2月6日

【四半期会計期間】 第101期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)

【会社名】 株式会社東京精密

【英訳名】 TOKYO SEIMITSU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 C O O 木 村 龍 一

【本店の所在の場所】 東京都八王子市石川町2968番地2

【電話番号】 (042)642 - 1701(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 C F O 川 村 浩 一

【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市石川町2968番地2

【電話番号】 (042)642 - 1701(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 C F O 川 村 浩 一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年11月7日に提出いたしました第101期第2四半期(自2023年7月1日至2023年9月30日)の四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 第一部 企業情報

#### 第2 事業の状況

##### 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

###### (1) 財政状態及び経営成績の状況

#### 第4 経理の状況

##### 1 四半期連結財務諸表

###### 注記事項

###### (セグメント情報等)

###### セグメント情報

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

### 第一部【企業情報】

#### 第2【事業の状況】

##### 2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

###### (1) 財政状態及び経営成績の状況

###### (訂正前)

(省略)

半導体製造装置

(省略)

この結果、当第2四半期連結累計期間における当セグメントの業績は、売上高46,964百万円(前年同四半期比 15.2%減)、営業利益9,298百万円(同33.2%減)となりました。

計測機器

(省略)

この結果、当第2四半期連結累計期間における当セグメントの業績は、売上高16,573百万円(前年同四半期比 5.7%増)、営業利益2,090百万円(同18.7%増)となりました。

(省略)

###### (訂正後)

(省略)

半導体製造装置

(省略)

この結果、当第2四半期連結累計期間における当セグメントの業績は、売上高46,964百万円(前年同四半期比 15.2%減)、営業利益8,982百万円(同35.5%減)となりました。

計測機器

(省略)

この結果、当第2四半期連結累計期間における当セグメントの業績は、売上高16,573百万円(前年同四半期比 5.7%増)、営業利益2,407百万円(同36.6%増)となりました。

(省略)

第4【経理の状況】

1【四半期連結財務諸表】

【注記事項】

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(訂正前)

(省略)

当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント		合計
	半導体製造装置	計測機器	
売上高			
外部顧客への売上高	46,964	16,573	63,537
セグメント間の内部売上高 又は振替高			
計	46,964	16,573	63,537
セグメント利益	<u>9,298</u>	<u>2,090</u>	11,389

(省略)

(訂正後)

(省略)

当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント		合計
	半導体製造装置	計測機器	
売上高			
外部顧客への売上高	46,964	16,573	63,537
セグメント間の内部売上高 又は振替高			
計	46,964	16,573	63,537
セグメント利益	<u>8,982</u>	<u>2,407</u>	11,389

(省略)

以上